

第五届华人芯片设计技术研讨会

2023年3月22-24日

深圳福田香格里拉酒店

主办单位

东南大学、复旦大学、澳门大学、电子科技大学、清华大学

承办单位

华芯设集成电路技术中心

支持单位

深圳福田区人民政府、河套深港科技创新合作区建设发展事务署

华人芯片设计技术研讨会（ICAC Workshop）致力于为中国集成电路设计的学术界和产业界同仁建立一个顶尖的技术交流平台，营造开放的技术讨论氛围，促进可能的合作，激发新的想法和方向，集思广益，共同提高。每届会议将特别邀请过去一年中发表了ISSCC或JSSC的中国顶尖IC设计学者/工程师在论坛上做学术报告，旨在和中国的IC产业一起共同成长，吸引众多IC领域学者参会。

 67 特邀报告人

 43 学生海报

 9 赞助企业

 837 参会人

会议现场





2023年3月22日上午，ICAC 2024正式开幕。福田区委副书记、区长周江涛，福田区副区长、福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署署长欧阳绘宇等嘉宾隆重出席会议。澳门大学副校长马许愿教授、香港科技大学副校长郑光廷教授作重磅大会报告。

嘉宾演讲



• 周江涛 •



• 欧阳绘宇 •



• 马许愿 •



• 郑光廷 •

3月22日晚，ICAC 2024芯片产业论坛举办，共话芯片设计的现状和未来。纽瑞芯研发副总裁陈润、晶华微上海分公司总经理李建、澳门大学副教授、博士生导师路延、矽力杰半导体研发副总裁袁小龙、思瑞浦研发设计总监郑晨、博通集成董事长、总经理张鸟飞参与论坛。



作为会议的服务方，亚昂完成了会议收稿及审稿，发送会议通知，制定会议流程和时间表，联系场地，会议室，餐饮，协调设备供应商，准备会议资料及礼品的定制及采购，会议宣传，邀请参会嘉宾，安排接待嘉宾等各项会前准备工作，会议现场热诚服务，并在会后协助学校和协会出具财务决算报告，深度合作IEEE，完成会议文章出版，上线等工作。ICAC 2024继续由亚昂提供服务。